

中电科芯片技术股份有限公司
关于预计公司及控股子公司 2025 年度向关联方
或商业银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● **综合授信额度:** 公司及控股子公司 2025 年度拟向关联方中国电子科技财务有限公司（以下简称“电科财务”）或商业银行申请不超过人民币 26,000 万元的综合授信额度，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

● **关联人回避事宜:** 公司第十三届董事会第二次会议审议本关联交易议案时，关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避。

本次关联交易尚须获得公司股东大会批准，关联股东中电科芯片技术(集团)有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业(有限合伙)需在股东大会审议时予以回避。

一、综合授信情况

2025 年度公司及控股子公司拟向电科财务或商业银行申请综合授信额度不超过人民币 26,000 万元，期限为 12 个月，在综合授信额度内办理包括但不限于贷款、票据业务、保函、信用证等有关业务。

为提高工作效率，及时办理相关业务，董事会提请股东大会授权经营管理层在上述总额度内，可对各公司的综合授信进行调剂使用。同时，授权经营管理层

及授权人士全权代表公司及控股子公司签署上述综合授信事项下的全部法律文件。在上述综合授信额度内，各公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体综合授信协议，不再单独履行决策程序。

由于电科财务为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”）控制的公司，并经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，为中国电科及其成员单位提供金融服务的非银行金融机构。公司及子公司向电科财务申请综合授信额度按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定构成关联交易。本议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，待上级单位审批后方可实施。

二、关联方电科财务基本情况

1、公司名称：中国电子科技财务有限公司

2、统一社会信用代码：91110000717834993R

3、金融许可证机构编码：L0167H211000001

4、法定代表人：杨志军

5、注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼1011、3-8层

6、注册资本：580,000万元人民币

7、经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

8、主要财务情况

单位：人民币亿元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日（未经审计）
总资产	1,185.42	824.89
净资产	113.23	114.01
营业收入	23.41	17.20
净利润	11.92	9.17
资产负债率	90.45%	86.18%

三、控股子公司基本情况

1、西南设计基本情况

(1) 公司名称：重庆西南集成电路设计有限责任公司

(2) 统一社会信用代码：91500108450457331G

(3) 法定代表人：徐骅

(4) 成立日期：2000年06月30日

(5) 注册资本：4,103.24万元人民币

(6) 注册地址：重庆市南岸区南坪花园路14号

(7) 主营业务：一般项目：移动通讯集成电路及其它集成电路、模块和整机电路设计、生产、测试、销售；电路设计与制造技术咨询服务；与电子信息技术、计算机工程应用设计以及计算机数据库管理和设计软件开发相关的工程项目设计和技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外；）经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(8) 股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股100%

(9) 主要财务情况

单位：人民币万元

财务指标	2023年12月31日	2024年9月30日（未经审计）
总资产	191,889.30	186,203.89
净资产	145,168.62	154,101.68
营业收入	85,643.65	37,221.22
净利润	15,148.49	3,436.21
资产负债率	24.35%	17.24%

2、芯亿达基本情况

(1) 公司名称：重庆中科芯亿达电子有限公司

(2) 统一社会信用代码：91500106699253465D

(3) 法定代表人：许运

(4) 成立日期：2009 年 12 月 16 日

(5) 注册资本：1,776.2 万元人民币

(6) 注册地址：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号

(7) 主营业务：一般项目：半导体芯片、电子元器件、电子产品（不含电子出版物）的设计、生产、测试、销售，计算机软件开发、技术转让及技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(8) 股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股 100%

(9) 主要财务情况

单位：人民币万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	23,744.82	31,401.55
净资产	21,256.62	29,801.88
营业收入	15,374.80	9,707.02
净利润	3,696.29	1,535.73
资产负债率	10.48%	5.09%

3、瑞晶实业基本情况

(1) 公司名称：深圳市瑞晶实业有限公司

(2) 统一社会信用代码：91440300279353961U

(3) 法定代表人：戚瑞斌

(4) 成立日期：1997 年 06 月 24 日

(5) 注册资本：7,533.61 万元人民币

(6) 注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道吓坑一路 168 号恒利工业园 C1 栋

(7) 主营业务：一般经营项目是：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外、

限制的项目须限得许可后方可经营)。物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；5G 通信技术服务；智能车载设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：摩托车电器、锂电池及充电器、UPS 电源、开关电源、电源适配器、机顶盒、机动车电器、USB 智能排插、墙插产品、移动智能产品、智能家居产品、智能硬件产品、智能穿戴产品、音频模组、音响设备、声学设备、自动化设备、新能源和再生能源系统产品的研发、组装生产及销售。物联网设备制造；通信设备制造；智能车载设备制造。

(8) 股东结构：中电科芯片技术股份有限公司持股 100%

(9) 主要财务情况

单位：人民币万元

财务指标	2023 年 12 月 31 日	2024 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	70,529.32	65,909.34
净资产	49,703.47	56,831.31
营业收入	52,130.93	25,938.22
净利润	5,277.31	1,298.84
资产负债率	29.53%	13.77%

四、协议的主要内容

公司及子公司目前尚未签订相关综合授信协议，上述额度仅为拟申请的最高综合授信额度，具体综合授信协议将在上述额度内由各公司根据实际经营情况单次或逐笔与银行等金融机构协商确定，以实际签署的合同为准。

五、对公司的影响

公司及子公司向电科财务及商业银行申请授信额度，是为了更好地满足日常经营及发展需求，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，同时公司严格按照监管规则及内部规章制度要求对关联方交易实施审核，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、审议程序和专项意见

1、董事会审计委员会审议情况

2024年10月23日，公司召开第十三届董事会审计委员会第二次会议，审阅《关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，认为申请综合授信额度有利于公司提高资金融通效率，补充企业流动资金；子公司经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控，不会损害公司及股东利益。蒋迎明委员在审计委员会审议时予以回避，其他非关联委员一致同意提交公司第十三届董事会第二次会议审议，并由董事会提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2024年10月23日，公司召开第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审阅《关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，认为公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度事项，是为满足公司及控股子公司日常经营的资金需求，有助于公司及子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意提交公司第十三届董事会第二次会议审议，并由董事会提交股东大会审议。

3、董事会审议情况

2024年10月28日，公司召开第十三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，在审议本议案时，关联董事王颖先生、肖志强先生、马羽先生、蒋迎明先生、李儒章先生予以回避，同意将本议案提交股东大会审议，关联股东需在股东大会审议时予以回避。

4、监事会审议情况

2024年10月28日，公司召开第十三届监事会第二次会议审议通过了《关于预计公司及控股子公司2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度的议案》，监事会认为：公司预计2025年度向关联方或商业银行申请综合授信额度事项，是为满足公司及子公司日常经营及发展需要，子公司经营状况稳定，资信状况良好，整体风险可控，不会损害公司及股东利益。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 9 月 30 日，公司未对子公司提供担保，公司及子公司也未对外提供担保，无逾期担保情况。

八、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第十三届监事会第二次会议决议；
- 3、公司第十三届董事会审计委员会第二次会议决议；
- 4、公司第十三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日